

2024年3月期（2023年4月～2024年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2024年5月10日

内容：

- 連結決算の概要 常務執行役員 ファイナンスユニットGM 川本 弘
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、地政学的リスク、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

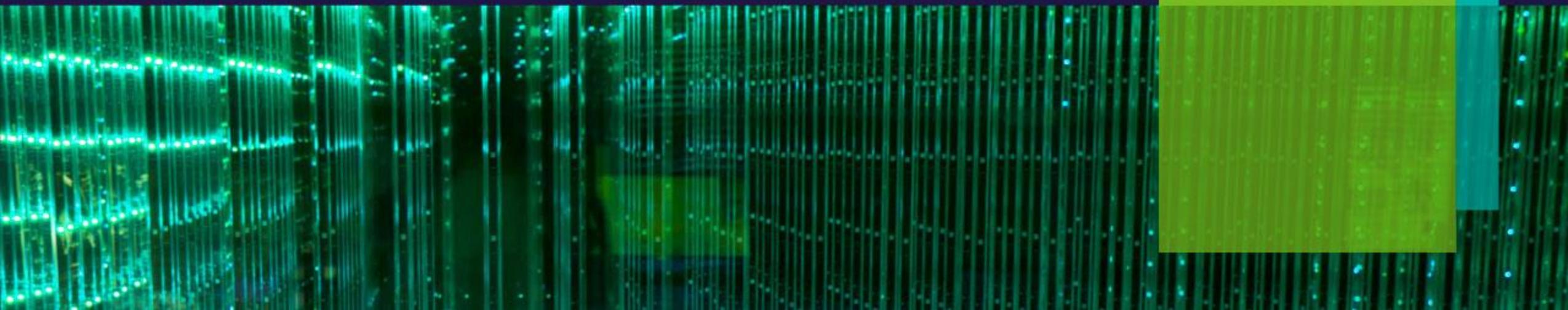
- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2024年3月期 連結決算の概要

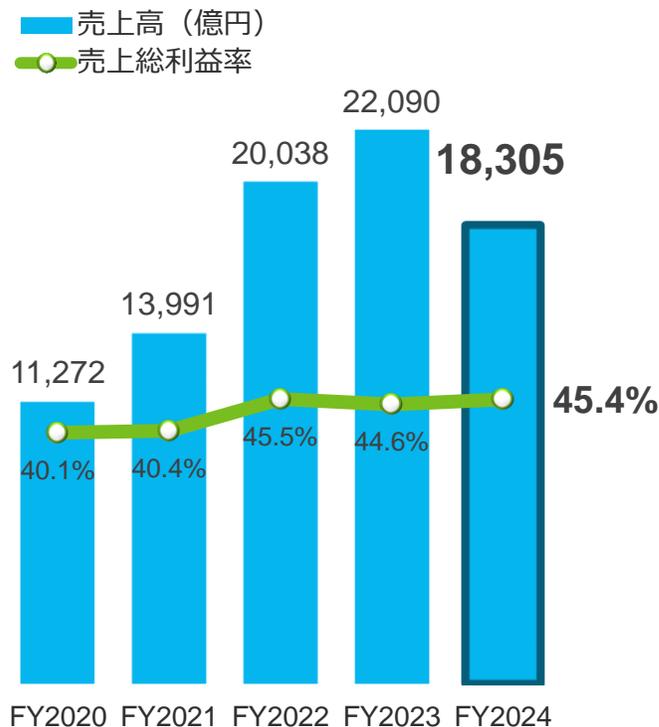
2024年5月10日

川本 弘
常務執行役員 ファイナンスユニットGM

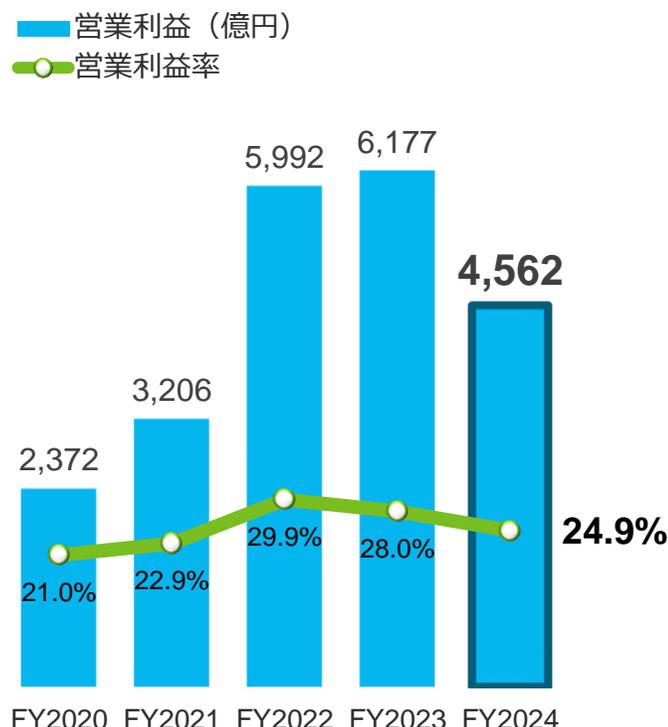


FY2024（2023年4月～2024年3月）財務ハイライト

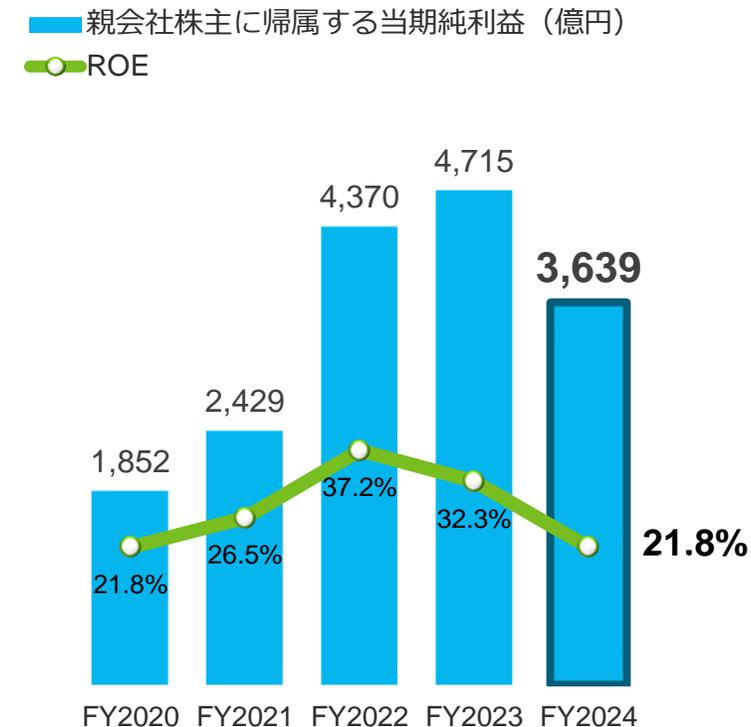
売上高と売上総利益率



営業利益と営業利益率



親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



FY2022の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。

売上高前期比17%減少も、高利益率製品の売上増加により、
売上総利益率は過去最高水準

損益状況

(億円)

	FY2023	FY2024	対前期 増減	(ご参考) 2024年2月9日発表の FY2024予想
売上高	22,090	18,305	-17.1%	18,300
売上総利益	9,844	8,302	-15.7%	8,170
売上総利益率	44.6%	45.4%	+0.8pts	44.6%
販管費	3,666	3,740	+2.0%	3,720
営業利益	6,177	4,562	-26.1%	4,450
営業利益率	28.0%	24.9%	-3.1pts	24.3%
税金等調整前当期純利益	6,248	4,734	-24.2%	4,500
親会社株主に帰属する当期純利益	4,715	3,639	-22.8%	3,400
1株当たり当期純利益 (円)	1,007.82	783.75	-22.2%	732.16
研究開発費	1,911	2,028	+6.1%	2,050
設備投資額	744	1,218	+63.7%	1,240
減価償却費	429	523	+21.9%	570

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています

3. 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。前連結会計年度の期首に当該株式分割がおこなわれたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しています

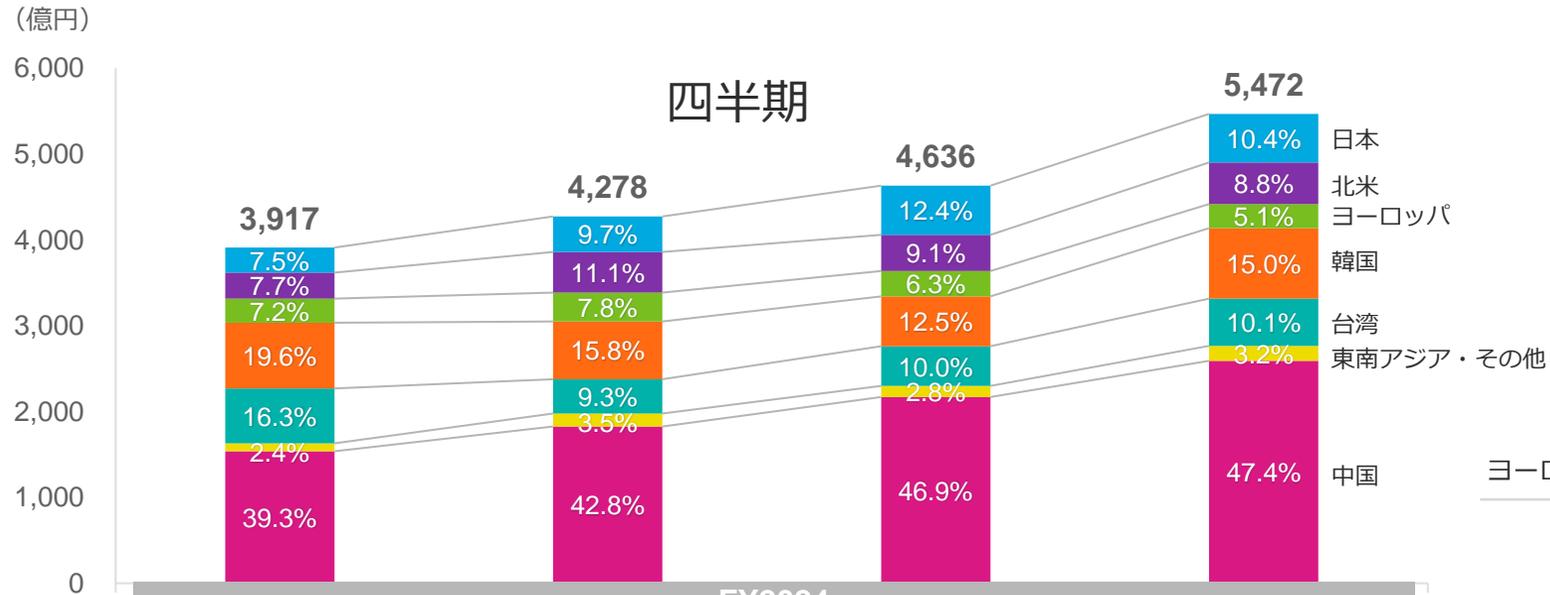
損益状況（四半期）

（億円）

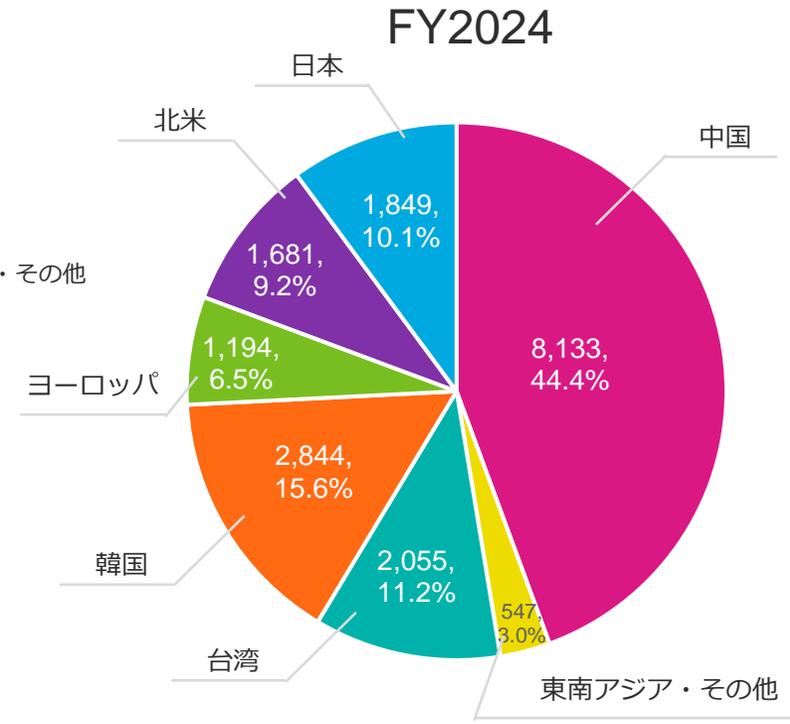
	FY2023	FY2024				QoQ	YoY
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	vs. Q3 FY2024	vs. Q4 FY2023
売上高	5,582	3,917	4,278	4,636	5,472	+18.0%	-2.0%
売上総利益	2,516	1,623	1,897	2,221	2,561	+15.3%	+1.8%
売上総利益率	45.1%	41.4%	44.3%	47.9%	46.8%	-1.1pts	+1.7pts
販管費	989	798	935	896	1,108	+23.7%	+12.1%
営業利益	1,527	824	961	1,324	1,452	+9.6%	-4.9%
営業利益率	27.4%	21.0%	22.5%	28.6%	26.5%	-2.1pts	-0.9pts
税金等調整前当期純利益	1,556	830	981	1,344	1,578	+17.4%	+1.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,186	643	731	1,015	1,249	+23.1%	+5.3%
研究開発費	537	436	510	497	584	+17.3%	+8.6%
設備投資額	263	393	176	318	329	+3.5%	+24.9%
減価償却費	120	106	125	138	153	+11.2%	+27.4%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

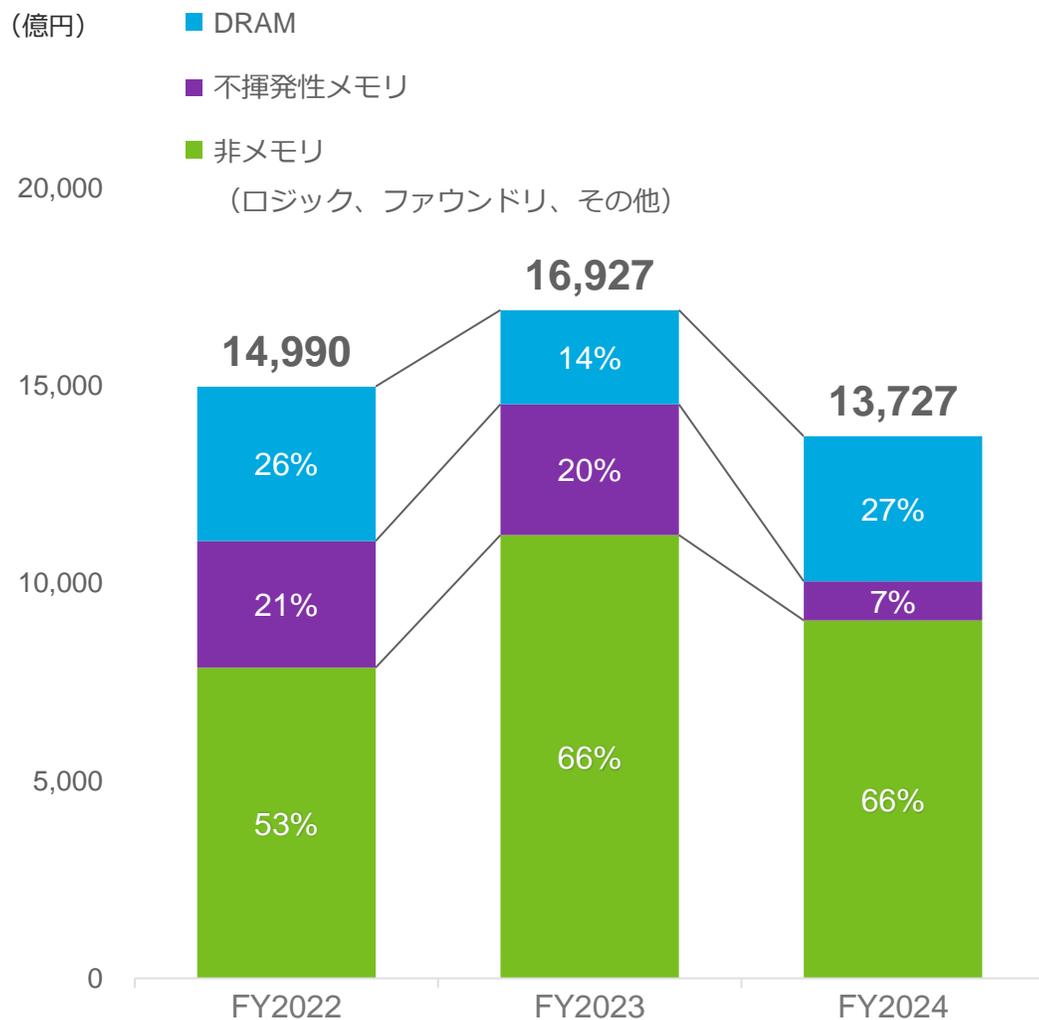
地域別売上高構成比 (FY2024 Q1~Q4)



	FY2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4
日本	295	412	574	567
北米	301	474	421	483
ヨーロッパ	281	335	294	281
韓国	767	674	582	820
台湾	639	399	463	552
東南アジア・その他	92	151	127	175
中国	1,539	1,829	2,172	2,591

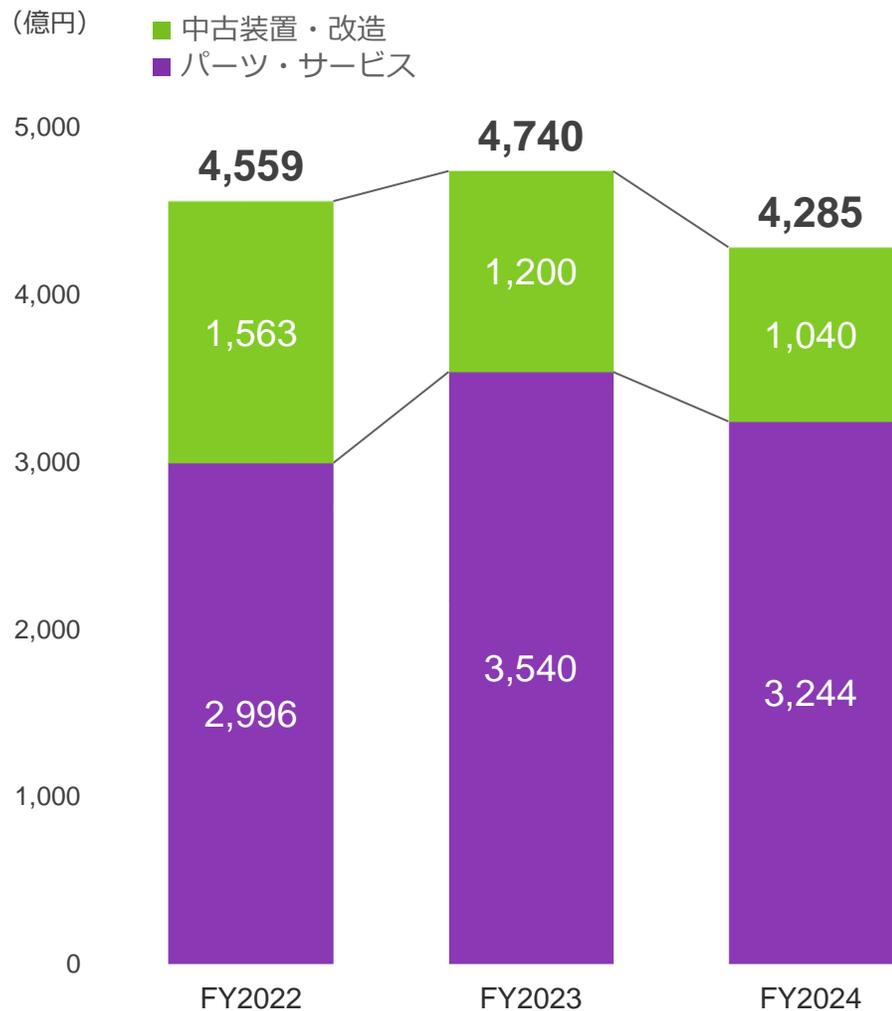


SPE*1新規装置 アプリケーション別売上構成比



- DRAM：中国顧客の旺盛な投資の結果、売上高、構成比ともに増加
- 不揮発性メモリ：顧客の在庫調整に伴う設備投資の抑制が続き、売上高・構成比ともに減少
- 非メモリ：先端向け設備投資は抑制されたものの、成熟向けが堅調

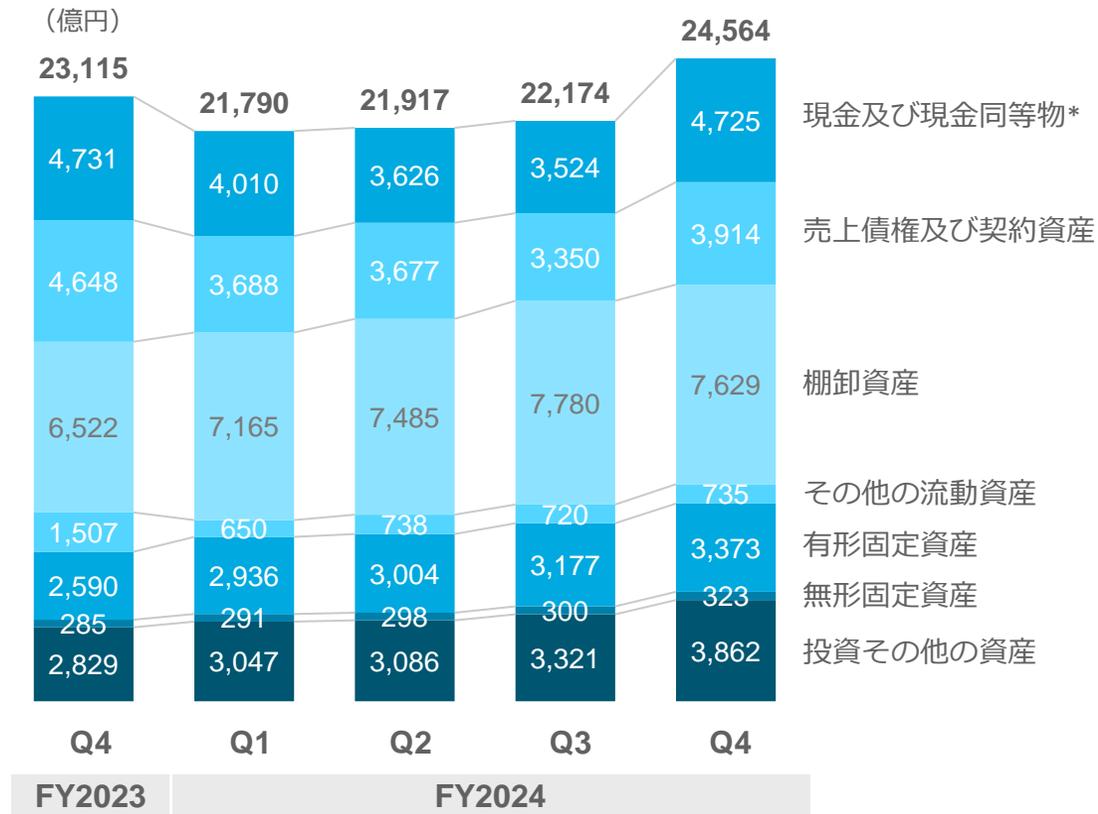
フィールドソリューション売上



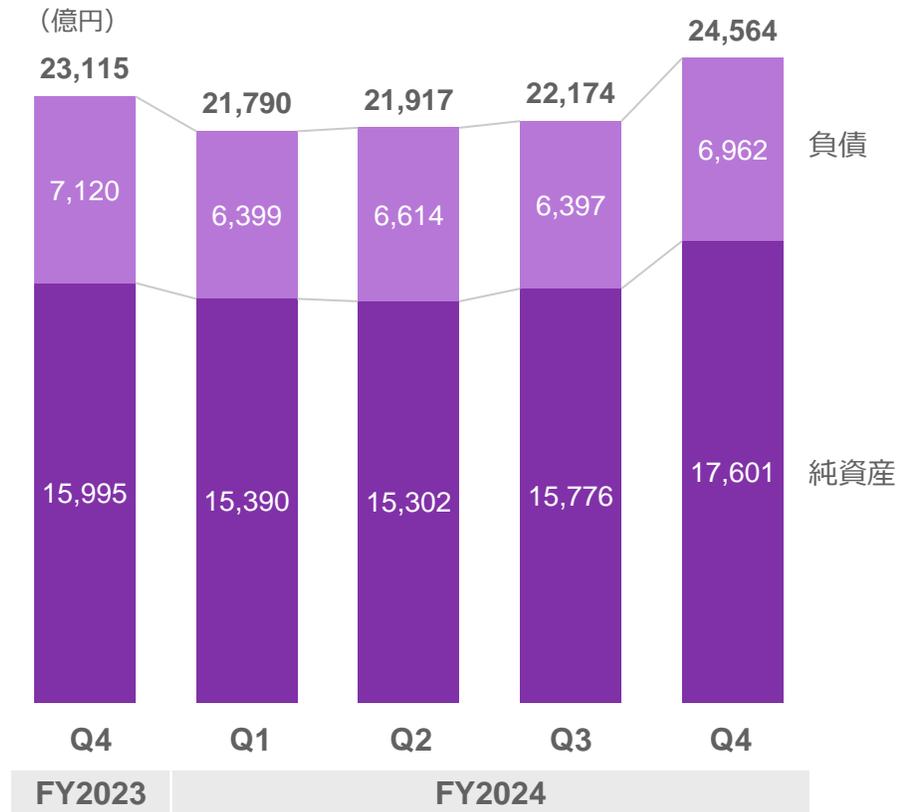
- FY2024 フィールドソリューションの売上は、前期比9.6%減の4,285億円
- 顧客の稼働率低下により、パーツ・サービス、中古装置・改造ともに減少

貸借対照表（四半期）

資産

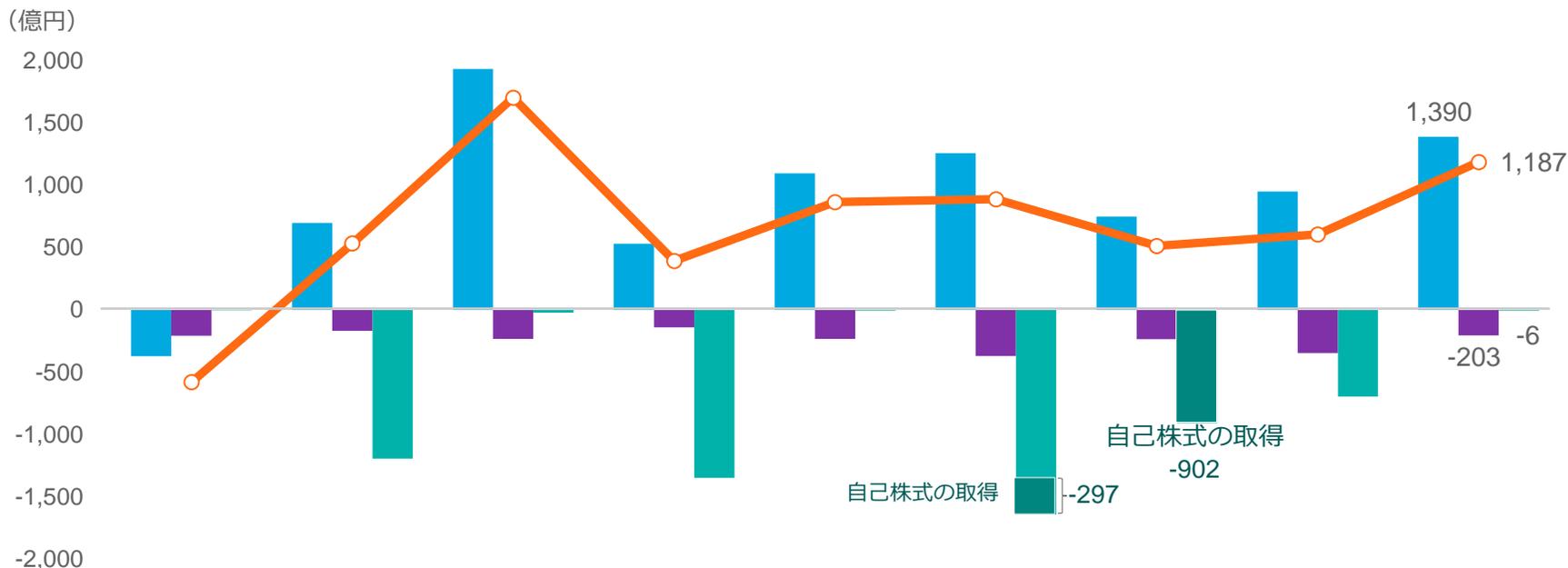


負債・純資産



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2022		FY2023				FY2024			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
■ 営業キャッシュ・フロー	-371	699	1,934	532	1,096	1,257	748	950	1,390	
■ 投資キャッシュ・フロー ^{*1}	-207	-166	-231	-138	-231	-368	-234	-344	-203	
■ 財務キャッシュ・フロー	-2	-1,191	-21	-1,346	-5	-1,641	-908	-693	-6	
○ フリーキャッシュ・フロー ^{*2}	-579	533	1,702	393	865	888	514	606	1,187	
■ 手元資金残高 ^{*3}	3,712	3,146	4,846	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2024年5月10日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



FY2024 事業ハイライト

- 売上高、利益額とも、期初計画を上回り着地
 - 売上高 1兆8,305億円、営業利益 4,562億円、当期純利益 3,639億円
- 過去最大となる2,028億円の研究開発投資を実施。山梨 新開発棟 2023年7月竣工
- 戦略製品によるPOR*¹獲得も順調。半導体の技術革新に貢献する新技術・新製品をリリース
 - 極低温エッチング、コンダクターエッチング、超臨界乾燥、HBM*²向けボンディングなど、幅広い装置群で数多くの量産POR、開発PORを獲得
- サステナビリティなど非財務領域においても進捗あり
 - 国内全事業所で再生可能エネルギー使用比率100%を達成、SBT*³認定を取得 等
 - ネットゼロ達成目標年を10年前倒し、CY2040に
 - SX 銘柄 2024に認定（2024年4月）
- 約1,200億円の自己株式取得を完了

*1 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*2 HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅DRAM

*3 SBT (Science Based Targets) : パリ協定が求める水準と整合した、5年~15年先の目標年として企業が設定する目標。

温室効果ガス排出削減目標を認定する国際的なイニシアティブ SBTiが、企業の温室効果ガス削減目標の評価をおこなっている

事業環境（2024年5月時点でのWFE市場の見方）

市場の見方に変更なし。CY2025に向けて回復基調

■ CY2024：\$100B程度と予測

– 年後半から、DDR5やHBM等の需要増による最先端DRAMの投資回復を見込む

■ CY2025：二桁成長を期待

– AIサーバーの成長が継続（CAGR 2023-2027：+31%*）

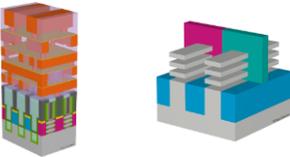
– PC・スマートフォンの需要回復

- オンデバイスAIなど、新たなアプリケーションに対応した新機能
- コロナ期に購入した製品の買い替え
- 企業のIT投資

→これらに伴い、先行するDRAMに加え、NANDと先端ロジック/ファウンドリの設備投資も回復すると予測

*Source : Omdia

事業機会と注力分野

	Logic	DRAM	NAND
デバイスイメージ			
デバイスへの要求	低電力・高速CPU	高速・高積層ワーキングメモリ	大容量ストレージ
技術変化	<ul style="list-style-type: none"> GAA Nanosheet Backside PDN*1 	<ul style="list-style-type: none"> EUV HKMG*2 CMOS周辺回路 HBMパッケージング 	<ul style="list-style-type: none"> 高積層化 / 多段化 周辺回路貼り合わせ メモリセル向け新材料導入
事業機会	<ul style="list-style-type: none"> 高選択比エッチング 新材料成膜 超臨界乾燥 ボンディング・レーザーエッジトリミング 	<ul style="list-style-type: none"> EUV向けコータ/デベロッパ 新材料成膜 超臨界乾燥 ボンディング・デボンディング 	<ul style="list-style-type: none"> HARCエッチング ウェットエッチング/新乾燥技術 新低抵抗メタル ボンディング ウェーハ反り抑制技術

成長機会はますます拡大

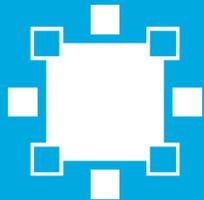
将来を見据えた研究開発投資

- 中期経営計画達成に向けた製品開発、および次世代・次々世代技術開発
 - 極低温エッチング
 - コンダクターエッチング
 - 枚葉ALD
 - コータ/デベロッパ新プラットフォーム
 - 最先端リソグラフィ 表面処理技術
 - アドバンスドパッケージング技術
- 国内/海外開発拠点の拡張およびリソース拡充
- 開発基盤の強化
 - ソフトウェア
 - DX
- 環境負荷低減、安全性能向上 など

未来に向けた成長投資（FY2025～FY2029）

研究開発費

1.5兆円



設備投資

7,000億円



人材採用

10,000人
毎年2,000人



FY2025 業績予想

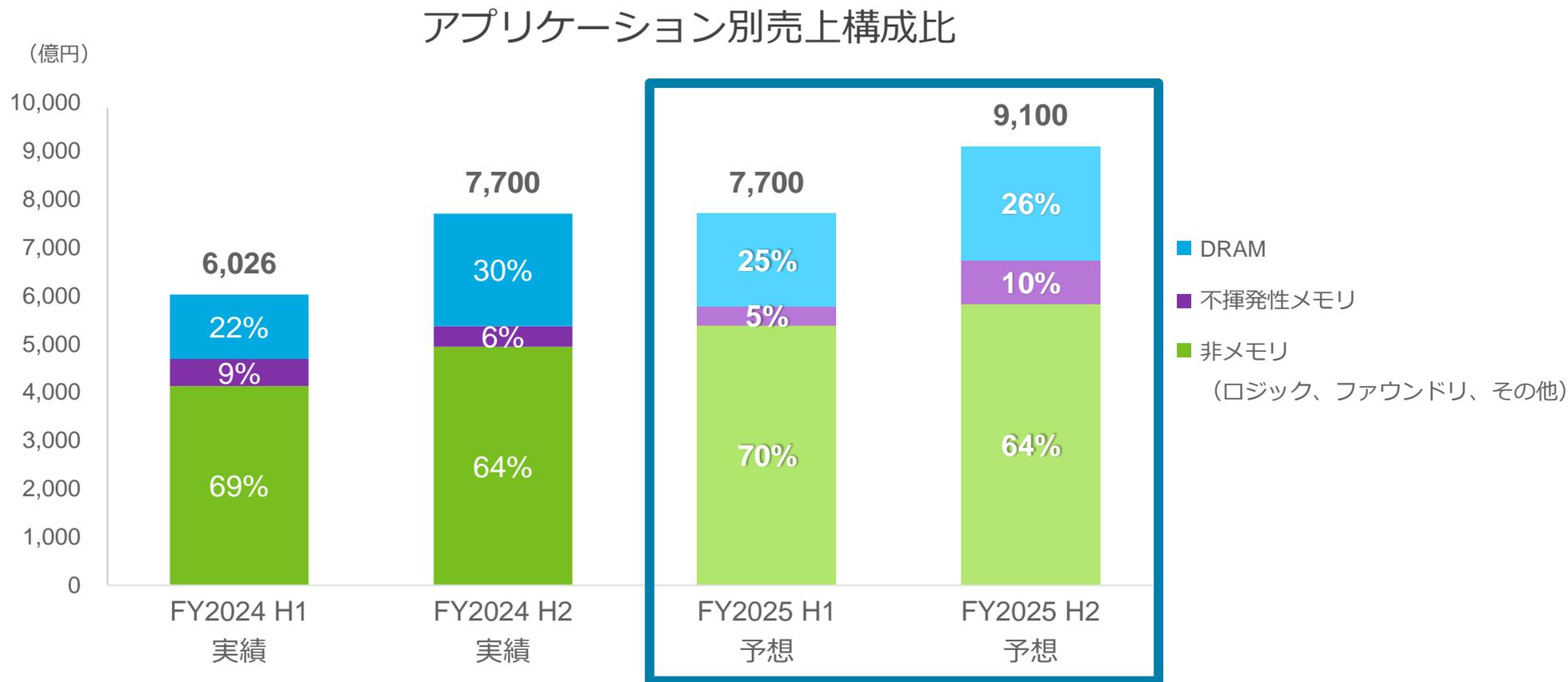
FY2025 業績予想

(億円)

	FY2024 (実績)	FY2025 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前期増減
売上高	18,305	10,000	12,000	22,000	+20.2%
売上総利益	8,302	4,540	5,680	10,220	+23.2%
売上総利益率	45.4%	45.4%	47.3%	46.5%	+1.1pts
販管費	3,740	2,110	2,290	4,400	+17.6%
研究開発費	2,028	1,180	1,320	2,500	+23.3%
研究開発費以外の販管費	1,711	930	970	1,900	+11.0%
営業利益	4,562	2,430	3,390	5,820	+27.6%
営業利益率	24.9%	24.3%	28.3%	26.5%	+1.6pts
税金等調整前当期純利益	4,734	2,440	3,400	5,840	+23.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	1,850	2,600	4,450	+22.3%
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	399.59	-	961.19	+177.44

FY2025は過去最高の売上総利益および売上総利益率を見込む。
将来の成長機会を最大限取り込むため、2,500億円の研究開発投資を計画

FY2025 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

前上期を底に、新規装置の売上は回復基調に。最先端投資の比重が高まる

FY2025 研究開発費・設備投資計画

新開発棟

成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県富士川町
2023年7月 竣工

東北生産・物流センター

成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟

コータ/デベロッパ、洗浄装置



熊本県合志市
2025年夏 竣工予定

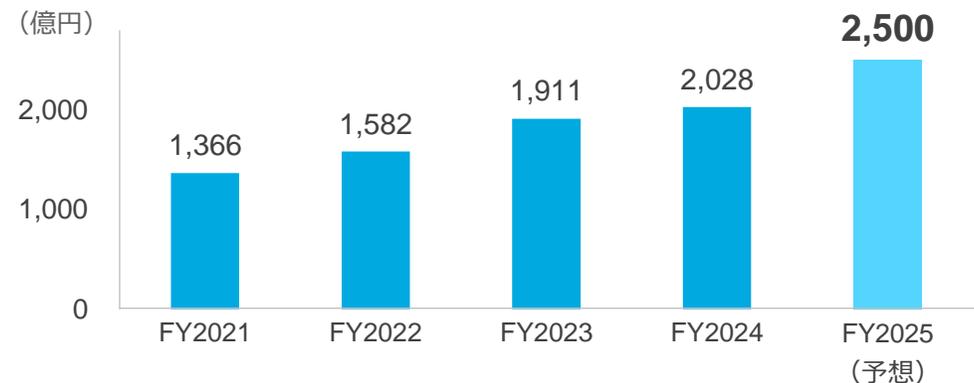
新開発棟

エッチング装置

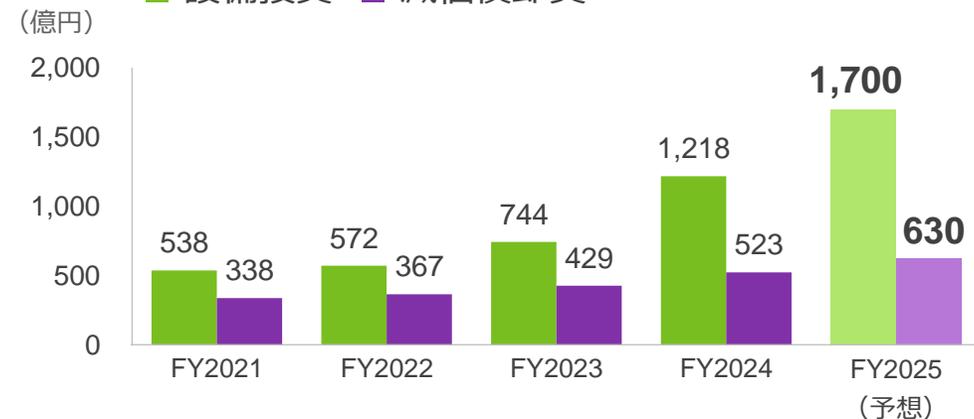


宮城県黒川郡
2025年春 竣工予定

■ 研究開発費



■ 設備投資 ■ 減価償却費



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

自己株式の取得について

最大800億円の自己株式取得を予定

- 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 : 350万株（上限）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 0.8%）
- 株式の取得価額の総額 : 800億円（上限）
- 取得する期間 : 2024年5月13日～2024年7月31日

キャッシュ創出力と必要手元資金、成長投資資金を考慮し、
今後も機動的にバランスシート・マネジメントをおこないます

FY2025 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない
2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

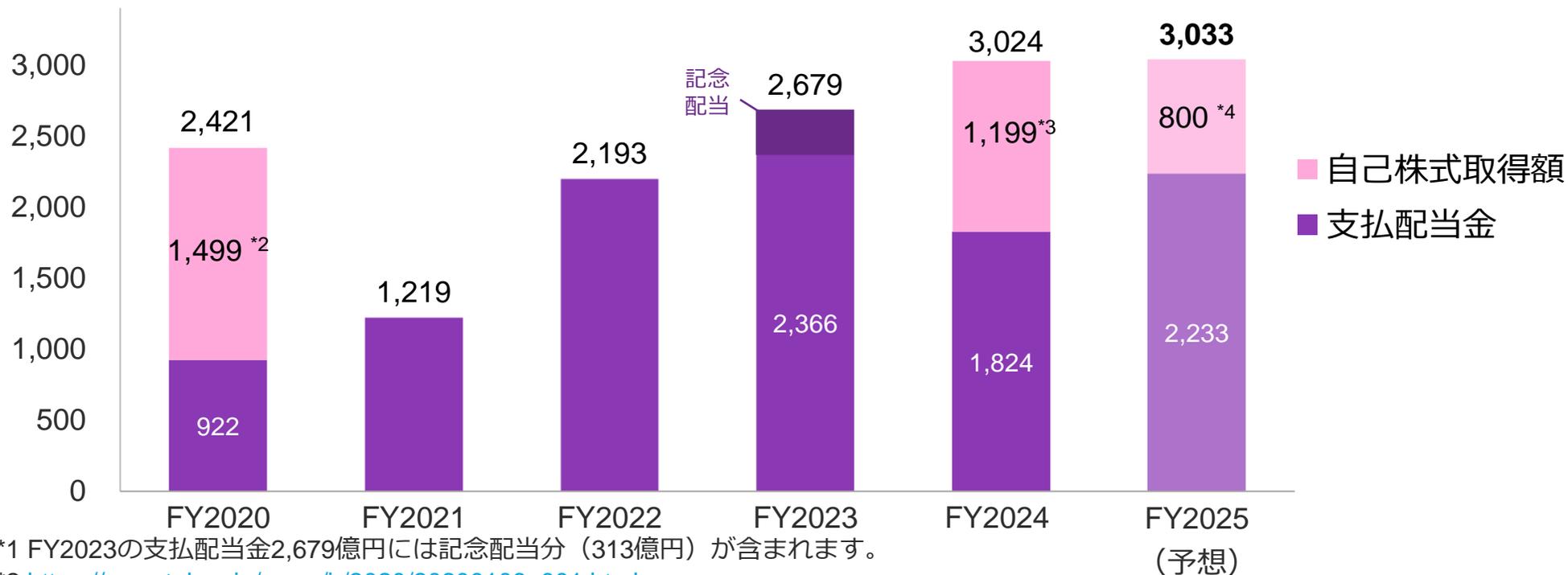
*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

- FY2020～2023の1株当たり配当額は、FY2020の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は481円を予定

総還元額

(億円)



*1 FY2023の支払配当金2,679億円には記念配当分（313億円）が含まれます。

*2 https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106_001.html

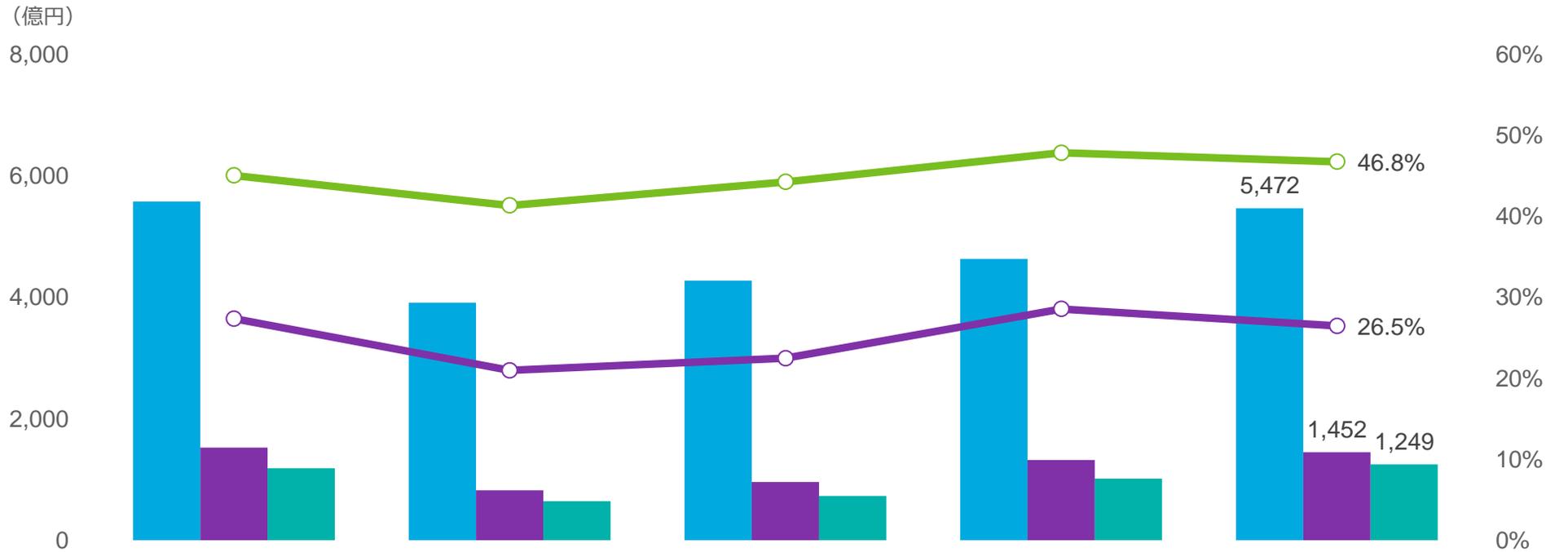
*3 https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002_001.pdf

*4 https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/r1apfs00000000mh-att/20240510_003.pdf

自己株式取得と合わせ、過去最高レベルの総還元額を見込む

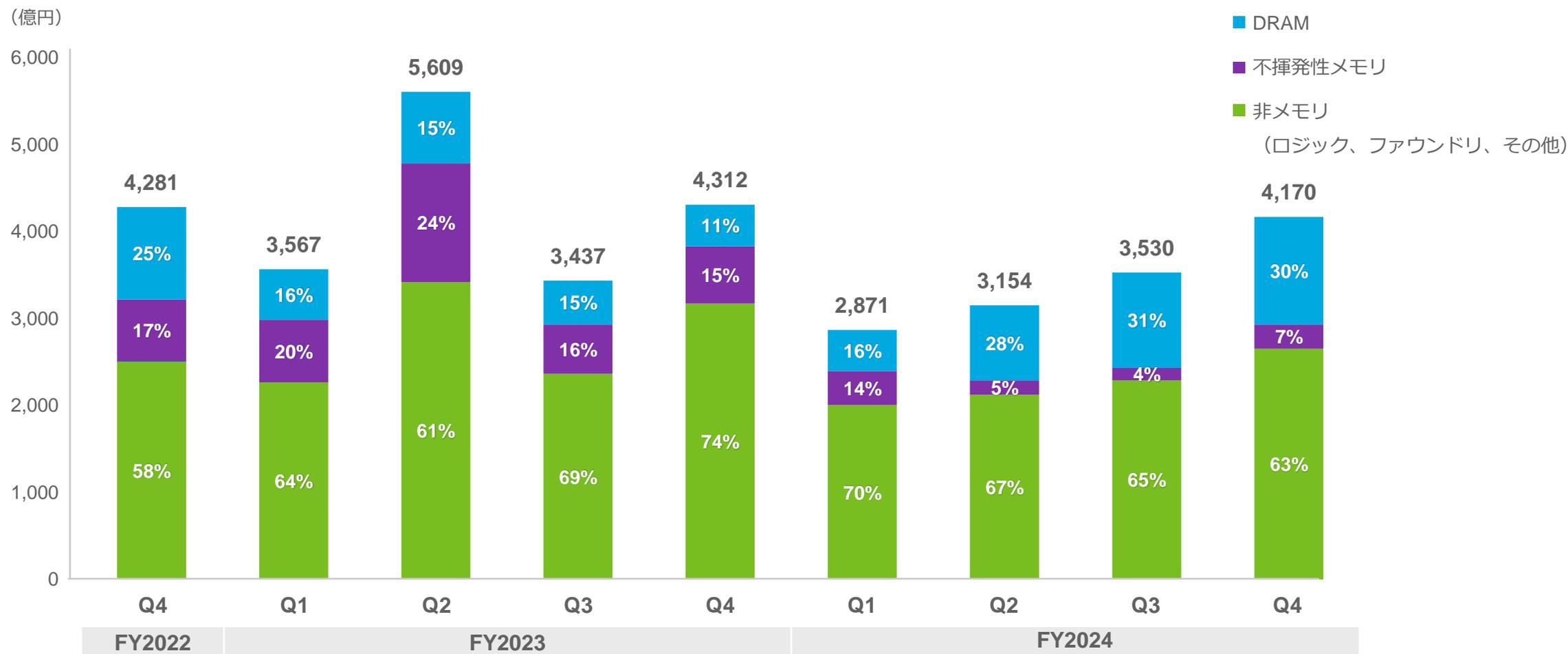
補足資料

損益状況（四半期）



	FY2023	FY2024			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
■ 売上高	5,582	3,917	4,278	4,636	5,472
■ 営業利益	1,527	824	961	1,324	1,452
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	1,186	643	731	1,015	1,249
○ 売上総利益率	45.1%	41.4%	44.3%	47.9%	46.8%
○ 営業利益率	27.4%	21.0%	22.5%	28.6%	26.5%

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



*1 SPE：半導体製造装置

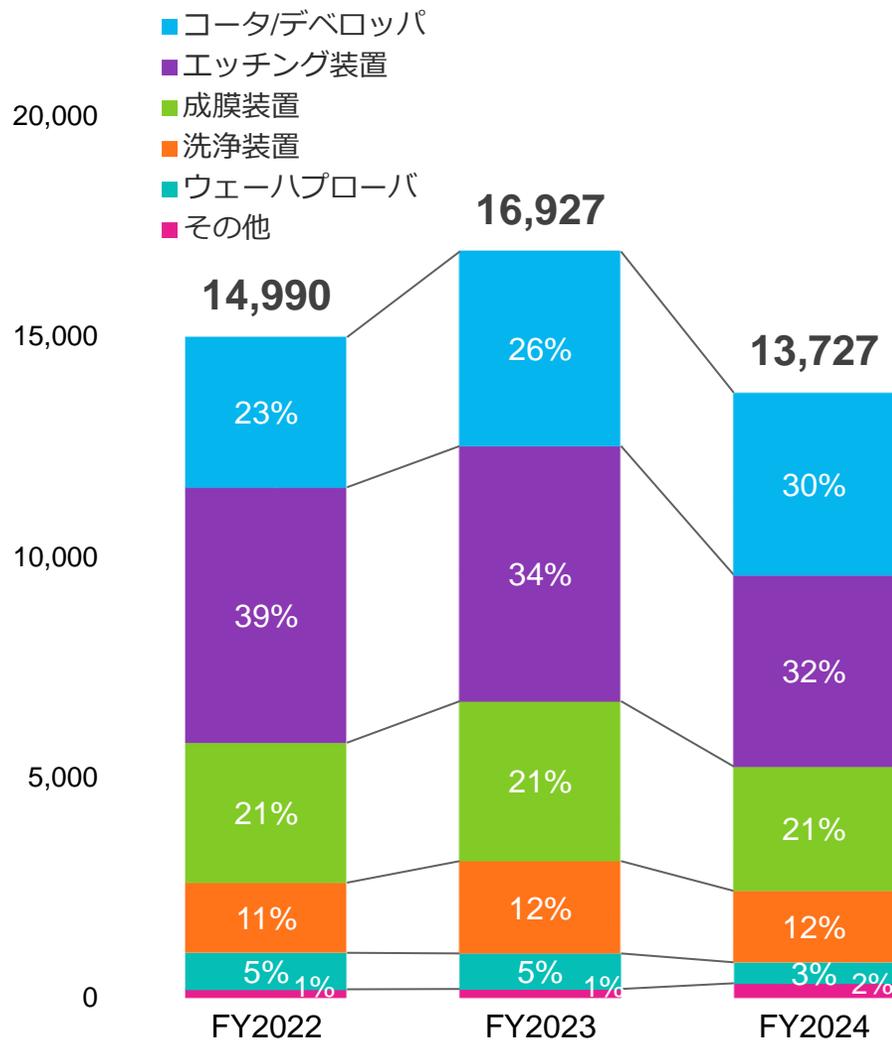
*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）



SPE新規装置 製品別売上構成比

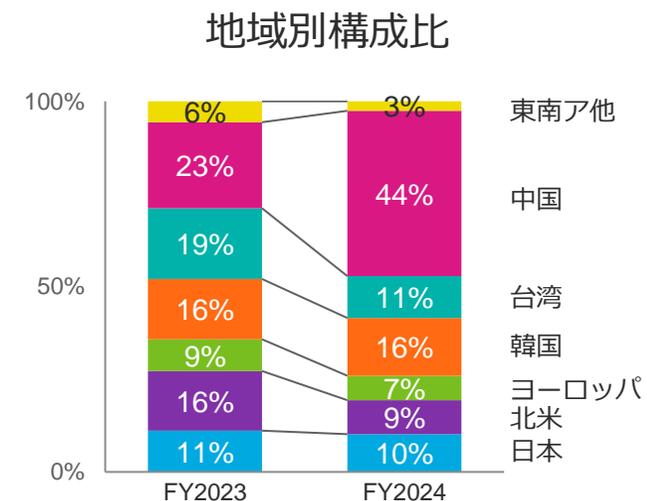
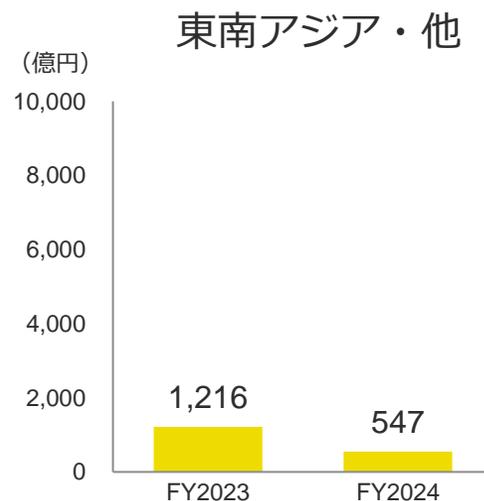
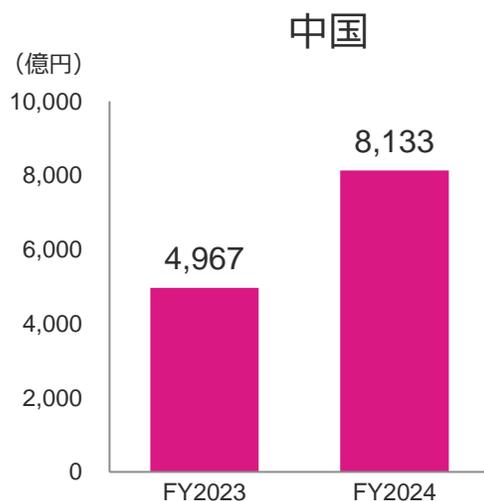
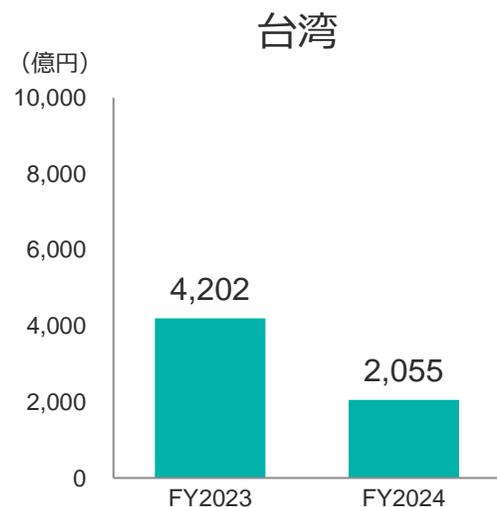
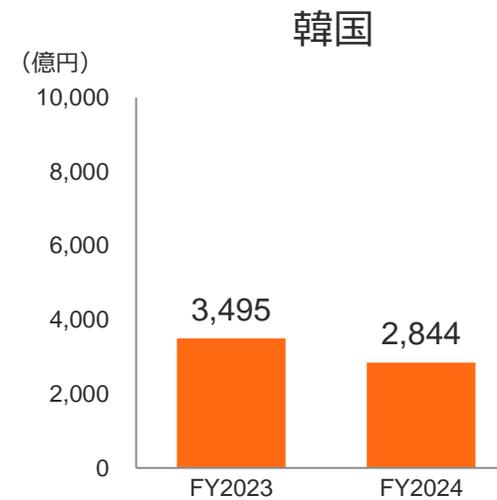
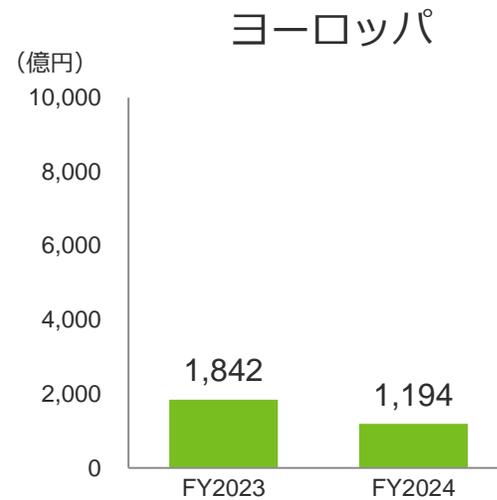
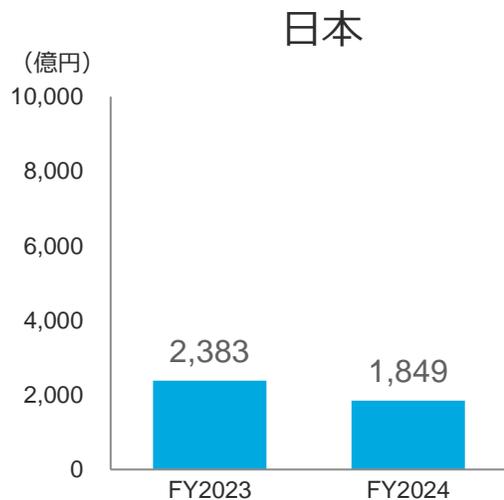
(億円)



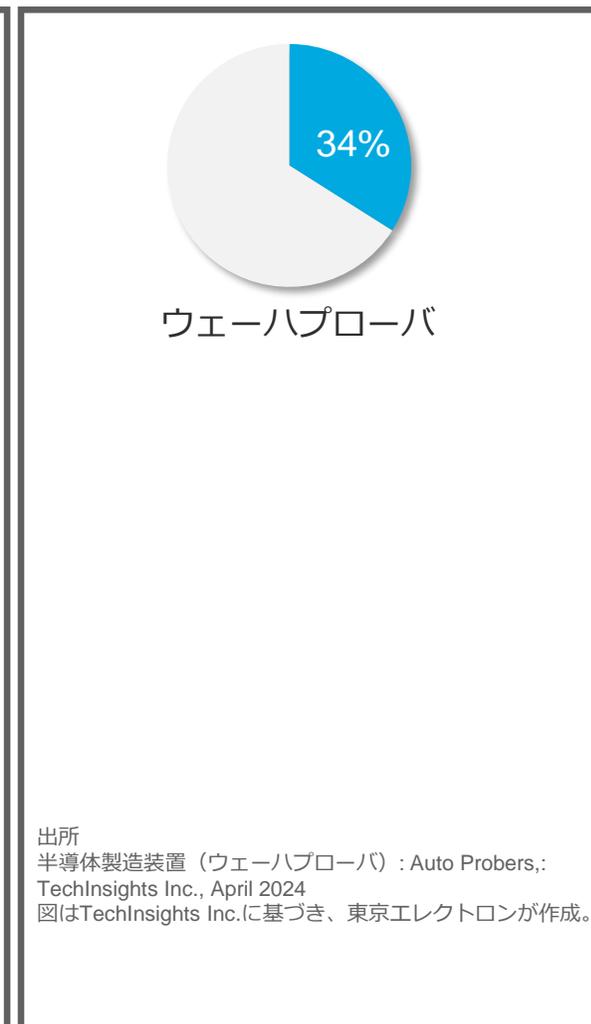
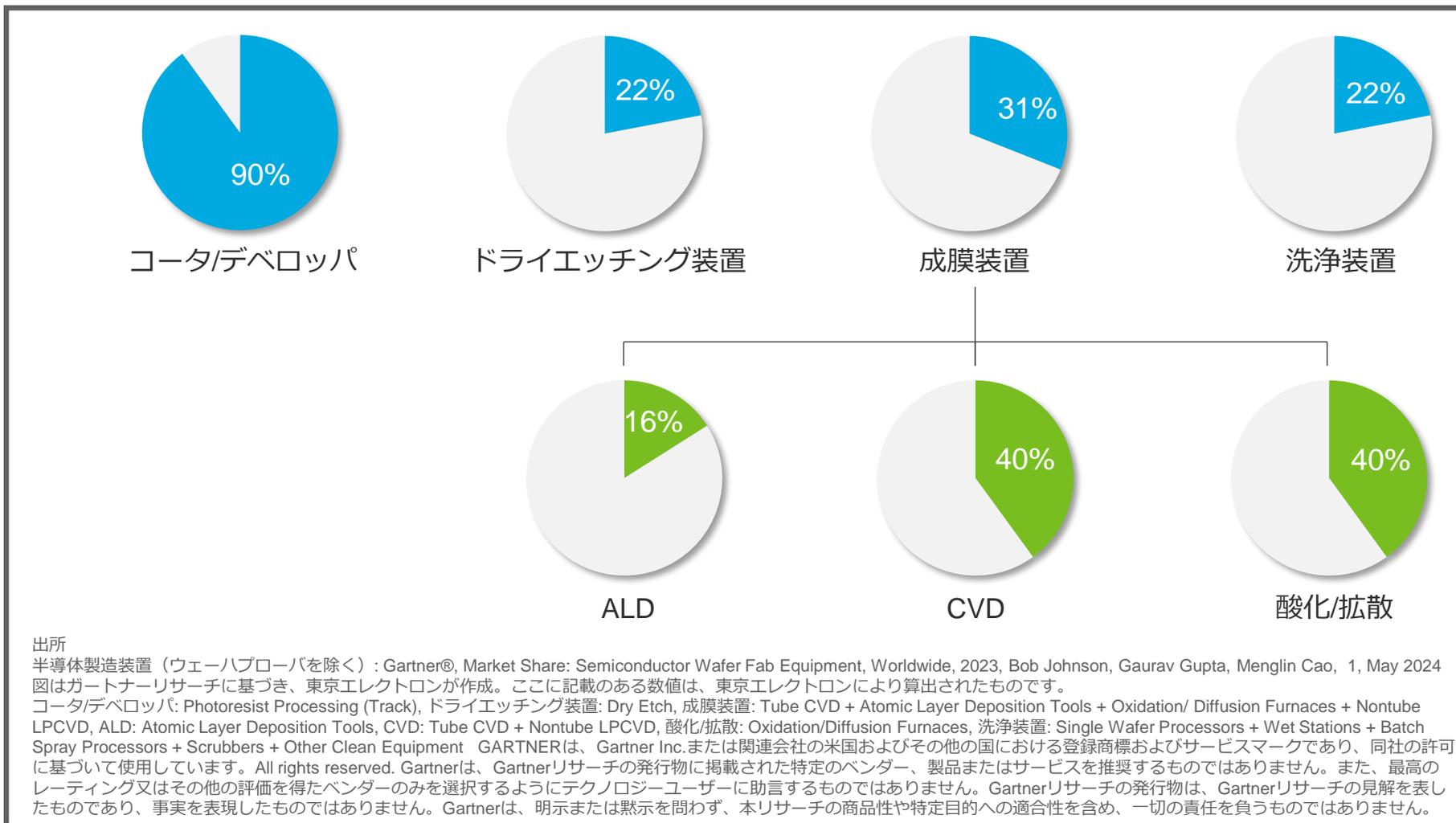
- FY2024 新規装置の売上は、前期比18.9%減の 13,727億円
- 顧客の設備投資の調整により、全体的に売上高が減少。一方、顧客のHBM向けの設備投資が増加し、その他の構成比が上昇

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません

地域別売上高



主要プロダクト 世界市場シェア (CY2023)



本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

TEL および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。

TEL

TOKYO ELECTRON